

2007年度決算説明会

2008年4月30日

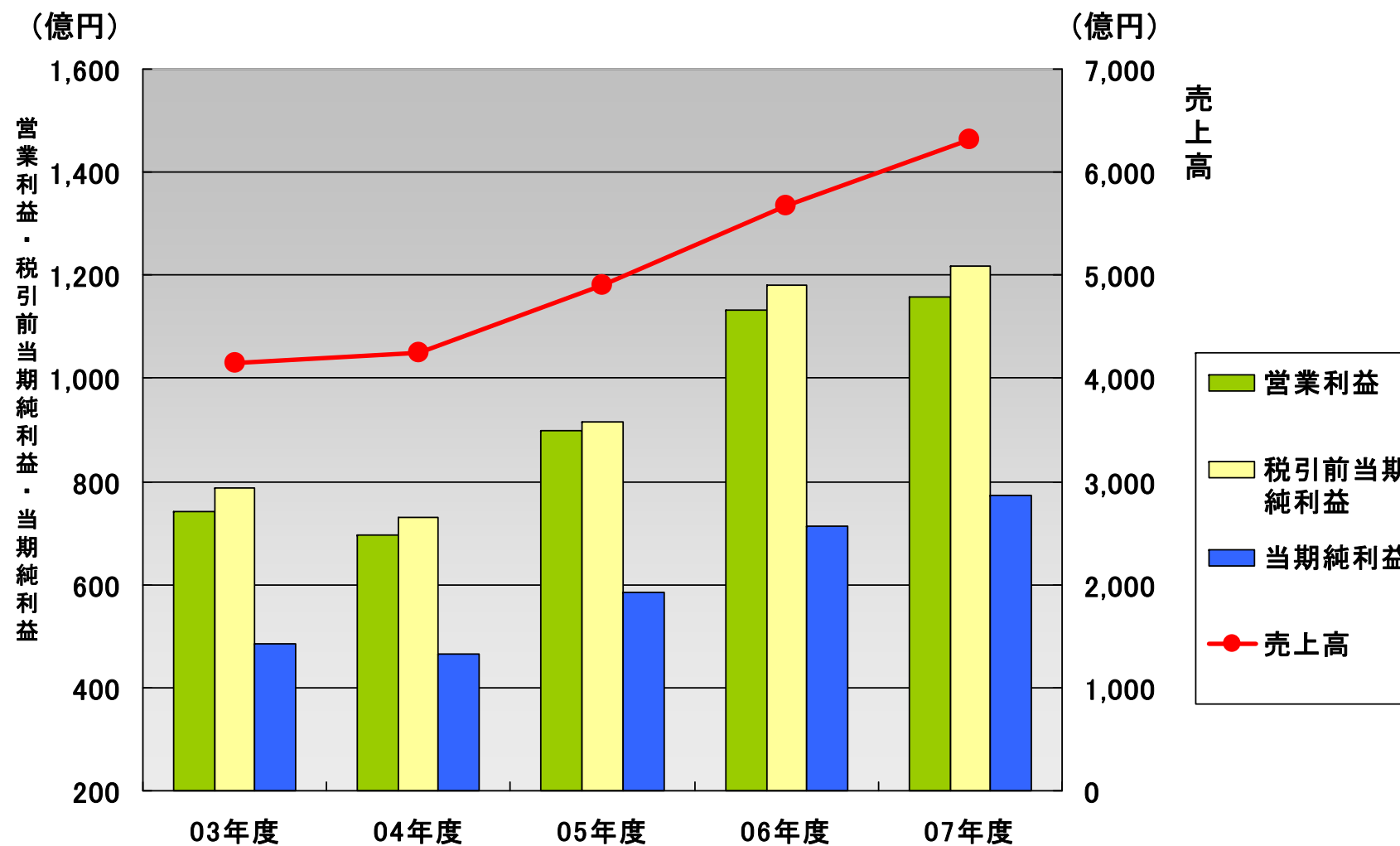
株式会社村田製作所



1. 2007年度 業績概要

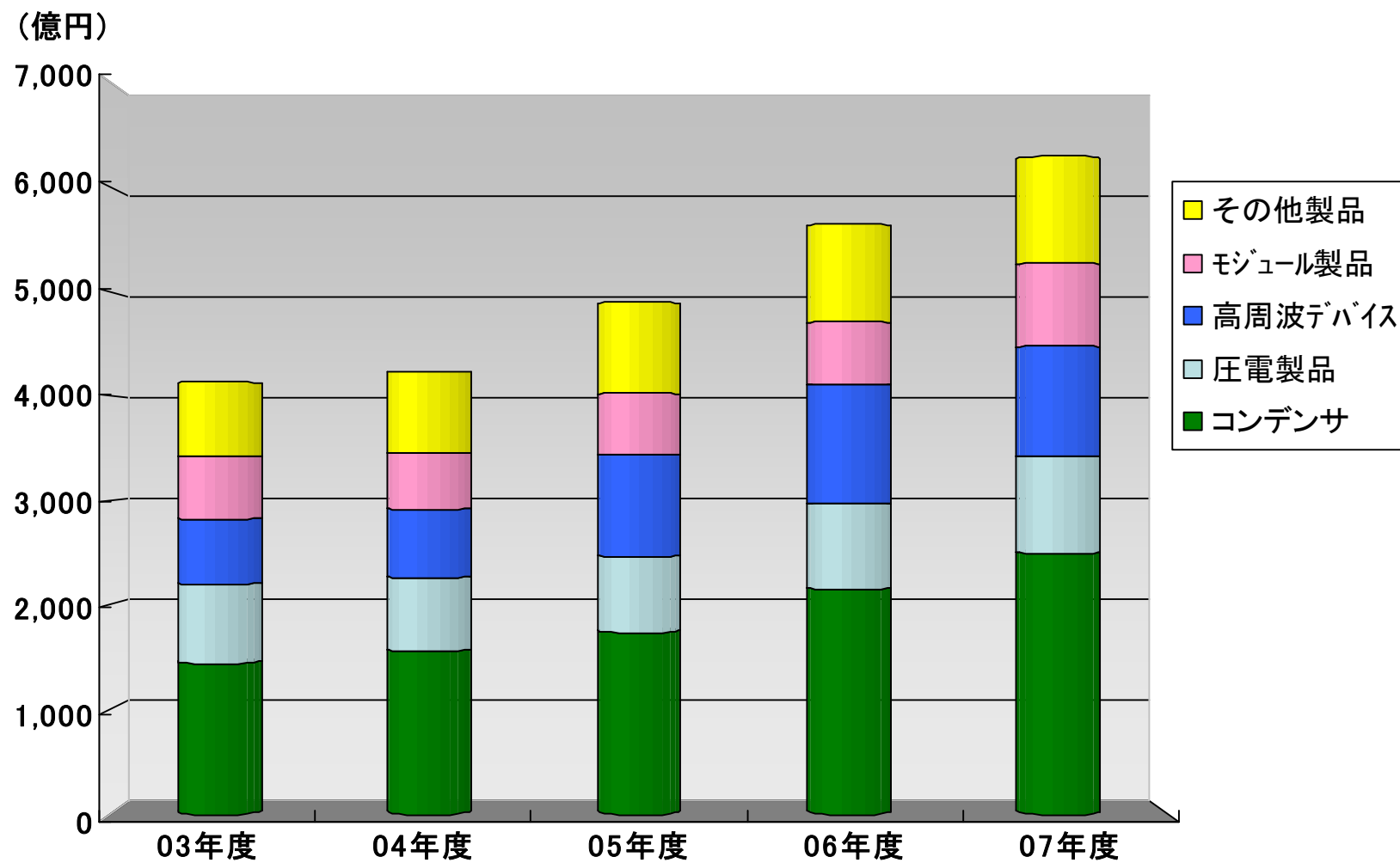
(2007年4月～2008年3月)

当期の業績概要



(注)03年度の営業利益には、厚生年金基金代行返上による117億円の増益要因が含まれております。

製品別売上高推移



製品別売上高

	2006年度		2007年度		増減	
	通期		通期			
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	2,153	38.1	2,494	39.6	+341	+15.9
圧電製品	816	14.4	927	14.7	+112	+13.7
高周波デバイス	1,141	20.2	1,054	16.7	▲87	▲7.6
モジュール製品	593	10.5	791	12.6	+198	+33.3
その他製品	946	16.8	1,029	16.4	+83	+8.8
製品売上高計	5,649	100.0	6,295	100.0	+647	+11.5

製品別売上高

コンデンサ

2、494億円(前期比+15.9%)

チップ積層セラミックコンデンサ

大容量品(1 μ F以上)

- AV機器や通信機器、PC及び関連機器向けなどのすべての用途で大幅に伸長

小型品(0603サイズ以下)

- 通信機器向けを中心に大幅に伸長

低ESL品

- プロダクトミックスの変化によりMPU向けで減少

製品別売上高

圧電製品

927億円(前期比+13.7%)

表面波フィルタ

- 携帯電話の生産台数増とマルチバンド化による
員数増加により需要拡大、シェアアップ

圧電センサ

- HDD向け、カーエレクトロニクス向けで増加

セラミック発振子

- PC及び関連機器向けで減少

セラミックフィルタ

- AV機器向け、通信機器向けで大幅に減少

製品別売上高

高周波デバイス

1、054億円(前期比▲7.6%)

近距離無線通信モジュール(Bluetooth®モジュール含む)

■AV機器向けが増加したが、通信機器向けで大幅に減少

多層デバイス

■通信機器向けで大幅に伸長

アイソレータ、コネクタ

■通信機器向けで大幅に伸長

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

製品別売上高

モジュール製品

791億円(前期比+33.3%)

電源

- AV機器向けやプリンタ向けで増加
- MPS電源の売上計上開始(07/9~08/3の7ヶ月分)

回路モジュール

- 携帯電話用地上デジタルチューナが増加
- 国内携帯電話向けの通信機器用モジュールが大きく増加

(注)MPS: Murata Power Solutions (07年8月米国C&Dテクノロジーズ社より買収したPower Electronics 事業部)

製品別売上高

その他製品

1、029億円(前期比+8.8%)

EMI除去フィルタ

- AV機器向けや通信機器向けで伸長

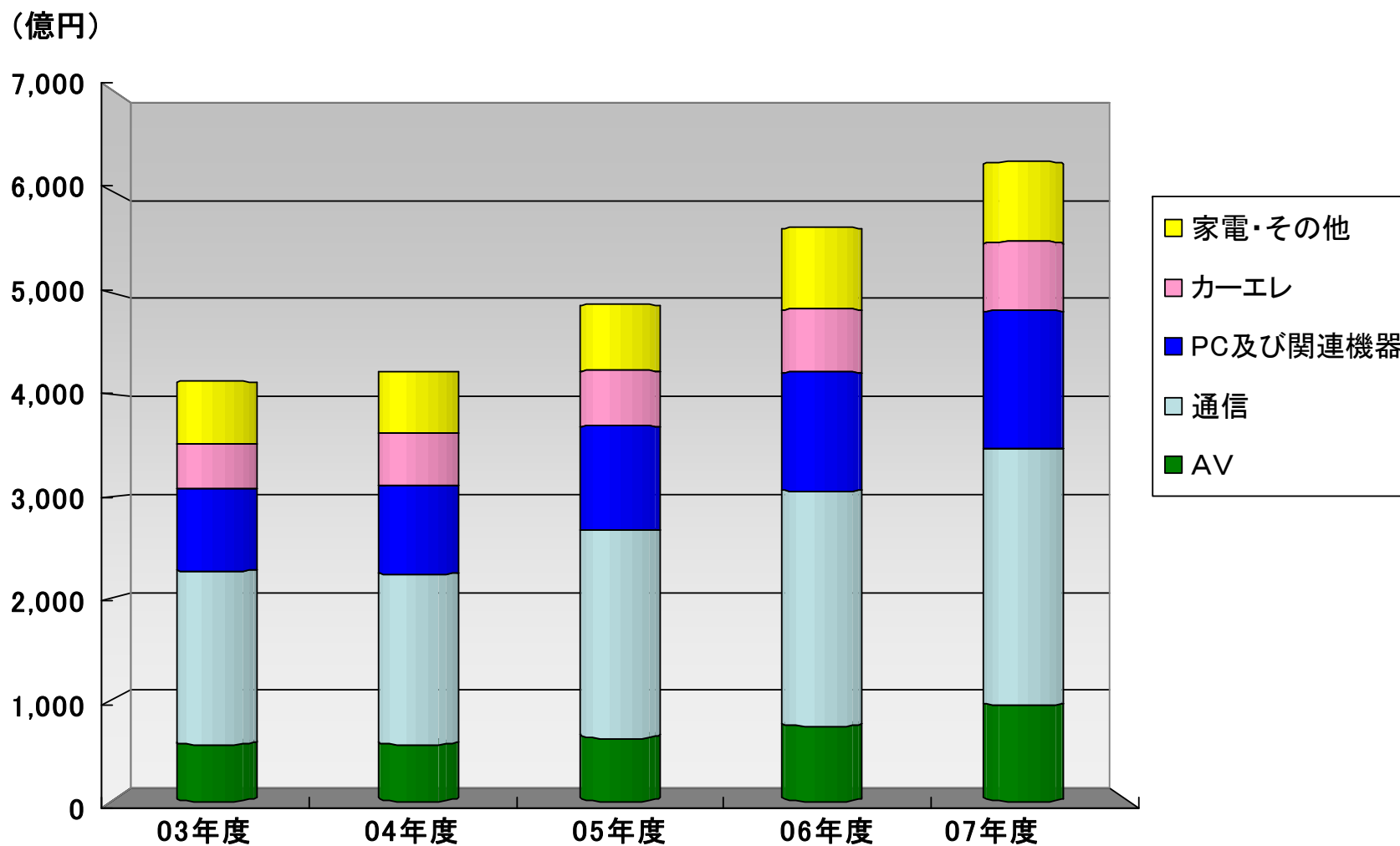
チップコイル

- 通信機器向け、AV機器向け、PC向けなどで大幅に伸長

ジャイロスター[®]

- デジタルカメラ向けで伸長

用途別売上高推移



用途別売上高

	2006年度 通期		2007年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	744	13.2	943	15.0	+199	+26.8
通信	2,306	40.8	2,523	40.1	+216	+9.4
PC及び関連機器	1,172	20.7	1,367	21.7	+195	+16.6
カーエレ	615	10.9	674	10.7	+59	+9.6
家電・その他	812	14.4	790	12.5	▲23	▲2.8
製品売上高計	5,649	100.0	6,295	100.0	+647	+11.5

用途別売上高

<p>AV機器向け (前期比+26.8%)</p>	<ul style="list-style-type: none">・薄型テレビやデジタルカメラの生産台数増加 →コンデンサ、EMI除去フィルタ、電源等が増加・ゲーム機向けが増加
<p>通信 (前期比+9.4%)</p>	<ul style="list-style-type: none">・第3世代機向けが大幅に伸長、 マルチバンド化による部品使用点数増加 →表面波フィルタ、小型コンデンサ、大容量コンデンサが伸長 多層デバイス、チップコイル、通信機器用モジュール、 地上デジタルチューナ等が増加
<p>PC及び関連機器 (前期比+16.6%)</p>	<ul style="list-style-type: none">・ノートPC及び関連機器向けの生産台数増加 →大容量コンデンサ、ショックセンサ、電源が増加・MPU向けは低ESLコンデンサが減少
<p>カーエレ (前期比+9.6%)</p>	<ul style="list-style-type: none">・自動車の電装化の進展に伴い、カーナビ向け、TPMS向け、 ソナー向けが増加

※TPMS:タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム

業績概況

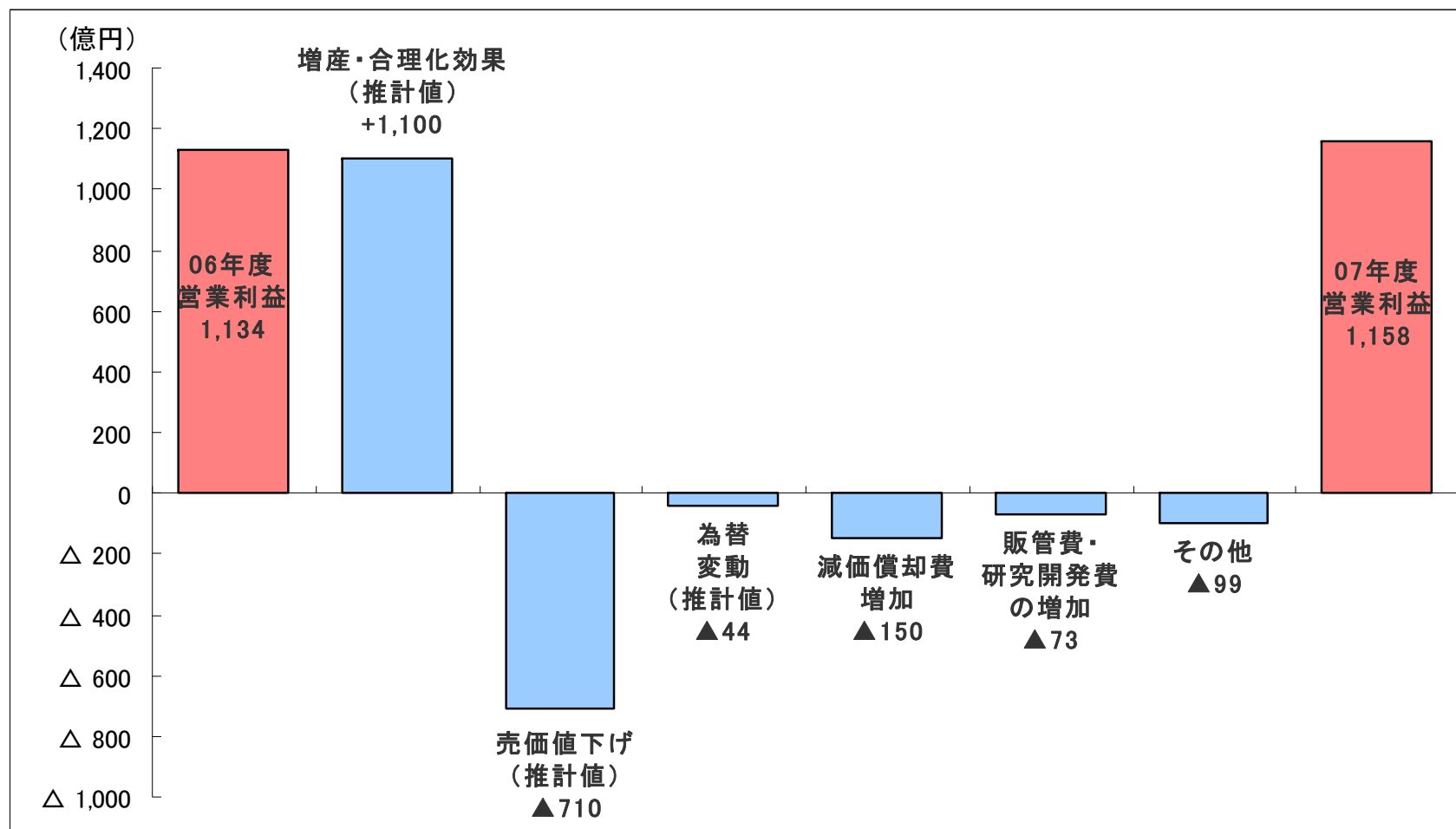


	2006年度 通期		2007年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	5,668	100.0	6,317	100.0	+649	+11.4
営業利益	1,134	20.0	1,158	18.3	+24	+2.1
税引前利益	1,180	20.8	1,218	19.3	+38	+3.2
当期純利益	713	12.6	774	12.3	+61	+8.6

(参考)

減価償却費	491	8.7	641	10.1	+150	+30.5
償却前営業利益	1,625	28.7	1,799	28.5	+174	+10.7

2007年度営業利益変動要因



2. 2008年度 業績予想

(2008年4月～2009年3月)

部品需要予測

携帯電話

11.6億台(2007年度) → 12.3億台(2008年度)

	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
販売台数	5.1	5.7	10.7	5.5	5.9	11.5	7%
部品需要台数	5.6	6.0	11.6	6.1	6.3	12.3	7%

(※当社推定値)

PC

2.8億台(2007年度) → 2.9億台(2008年度)

	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
販売台数	1.3	1.4	2.7	1.3	1.5	2.8	4%
部品需要台数	1.4	1.3	2.8	1.4	1.5	2.9	6%

(※当社推定値)

2008年度の業績予想



	2008年 上期予想		2008年 下期予想		2008年度 通期予想	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	3,200	+4.9	3,400	+4.1	6,600	+4.5
営業利益	370	▲37.1	430	▲24.5	800	▲30.9
税引前利益	395	▲35.0	455	▲25.5	850	▲30.2
当期純利益	250	▲34.1	280	▲29.0	530	▲31.5

(参考)

減価償却費	350	+23.7	400	+11.7	750	+17.0
償却前営業利益	720	▲17.3	830	▲10.5	1,550	▲13.8

※(%)は前年同期比伸び率

※四半期別売上高

Q1:1,540億円、Q2:1,660億円、Q3:1,760億円、Q4:1,640億円

業績予想の前提

	2007年度 実績	2008年度 予想
減価償却費	651億円	750億円
研究開発費	423億円	460億円
設備投資額	1,256億円	750億円
為替レート(US\$)	114.28円/US\$	100.00円/US\$



(参考)設備投資の内訳

	2007年度 実績	2008年度 予想	増減
	(億円)	(億円)	(億円)
生産設備	719	450	▲ 269
建物・土地	316	120	▲ 196
研究開発	105	90	▲ 15
その他	116	90	▲ 26
合計	1,256	750	▲ 506

業績予想(利益の増減要因)

	2007年度通期 実績		2008年度通期 予想		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	6,317	100.0	6,600	100.0	+283	+4.5
営業利益	1,158	18.3	800	12.1	▲ 358	▲30.9
税引前利益	1,218	19.3	850	12.9	▲ 368	▲30.2
当期純利益	774	12.3	530	8.0	▲ 244	▲31.5
(参考)						
減価償却費	641	10.1	750	11.4	+109	+17.0
償却前営業利益	1,799	28.5	1,550	23.5	▲ 249	▲13.8

利益変動要因

- ・増産・合理化効果
- ・対ドル円高(114.28円/US\$→100.00円/US\$)
- ・減価償却費の増加
- ・製品価格の値下がり
- ・研究開発費の増加
- ・プロダクトミックスの変化

用途別売上予想

	2007年度実績 (前期比)	2008年度予想 (前期比)
AV	+26.8%	+3%程度
通信 (うち携帯電話)	+9.4% (+9.5%)	+10%程度 (+13%程度)
PC及び関連機器	+16.6%	横ばい
カーエレ	+9.6%	+5%程度
家電・その他	▲2.8%	▲5%程度

製品別売上予想

	2007年度実績 (前期比)	2008年度予想 (前期比)
コンデンサ	+15.9%	+2%程度
圧電製品	+13.7%	+8%程度
高周波デバイス	▲7.6%	+15%程度
モジュール製品	+33.3%	+3%程度
その他製品	+8.8%	横ばい

配 当

2008年度(09年3月期)の配当(予定)
1株当たり年間100円(うち中間配当50円)

2007年度の配当実績
1株当たり年間100円(うち中間配当50円)

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります。

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。